산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	**보 도 자 료**	역동경제 평창

2017년 8월 24일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 8. 24.(목) 오전 6시 이후 보도 가능)

배포일시	2017. 8. 23.(수)	담당부서	전자부품과
담당과장	안세진 과장(044-203-4270)	담 당 자	이정남 사무관(044-203-4273)

반도체 업계 인력난, 대학생 취업난 동시해결
인하대, 대림대, 명지대, 한국산업기술대 반도체장비 전공트랙 출범

□ 산업통상자원부(장관 : 백운규)와 한국반도체산업협회(회장 : 박성욱 SK하이닉스 부회장)는 '17.8.24.(목) 10시 한국반도체산업협회에서 인하대, 대림대, 명지대, 한국산업기술대와 「반도체장비 전공트랙과정 출범식」을 개최했다.

<반도체장비 전공트랙 출범식 개요>

○ 일시/장소 : '17.8.24(목) 10:00 ~ 12:00 / 한국반도체산업협회(판교) ○ 참 석 자 : (산업부) 박기영 소재부품산업정책관, (인하대) 최순자 총장, (대림대) 황운광 총장, (명지대) 이종명 부총장, (산기대) 이재학 대학원장 (반도체 장비) 박경수 피에스케이 대표, (KIAT) 정재훈 원장

□ 산업부는 반도체 분야 대규모 시설투자로 반도체 장비분야 전문인력 수요가 급증함에 따라,

* 국내 반도체 장비 시장(억불) : ('16) 76.9 → (17) 129.7 → ('18) 133.8 (SEMI, '17.7월)

○ 한국반도체산업협회를 통해 반도체 장비기업을 대상으로 심층 인터뷰 및 설문조사를 기초로 교육과정을 기획하고, 인하대 등 4개 대학에 반도체장비 전공트랙과정을 개설했다.

○ 전공트랙과정은 메카트로닉스학과를 보유한 대림대·한국산업기술대는 장비제조 및 필드엔지니어를, 인하대·명지대는 전자·기계·화학·소재 등 전공 특성에 따라 설계, 소재, 소프트웨어 분야 전문인력을 양성한다.

* (인하대) 전자·기계·화학·신소재·정보통신공학과, (대림대) 메카트로닉스공학과, (명지대) 전자·기계·산업·신소재·정보통신공학과, (산기대) 나노광·메카트로닉스공학과

□ 반도체 업계와 참여 대학은 3학년 학생을 대상으로 총 116명의 트랙과정 참여학생을 선발하여 2017년 2학기부터 교육을 실시하게 된다.

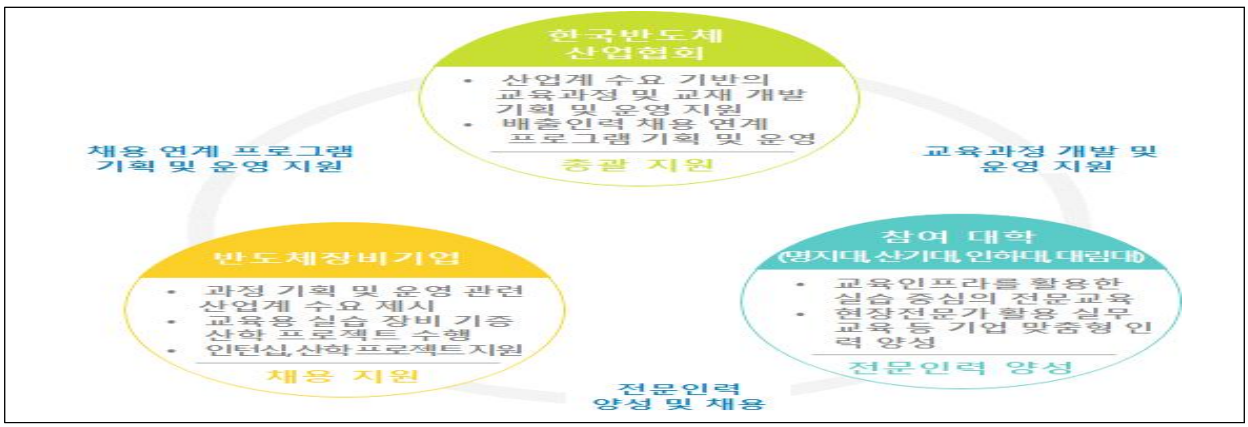
○ 대학에서는 우수한 학생 선발 및 교육을 위해 트랙과정 참여 학생에 장학금을 지원하고 실습과 프로젝트 중심의 교육 프로그램을 운영하며,

○ 산업계에서는 실습용 장비 기증, 고경력자(퇴직자) 출신 강사 파견 등을 통한 강의지원과 4학년 학생의 실습(인턴쉽) 프로그램을 통해 졸업후 바로 실무에 투입할 수 있는 현장중심의 인력양성과정을 지원한다.

□ 산업부는 반도체 장비업계가 양질의 일자리를 지속적으로 창출할 수 있도록 장비수요기업과 공동으로 공정장비 연구개발(R&D)도 추진한다.

* 미래반도체원천기술개발 : 정부·기업 공동투자로 반도체 공정 등 기술개발('17년 258억원)

○ 또한, 반도체장비 전공트랙과정을 이수한 학생들이 배출되는 2019년도에는 한국반도체산업협회를 통해 학생들에 기업 채용 정보를 제공하는 등 대학생들 취업을 집중 지원할 예정이다.



□ 산업부 박기영 소재부품산업정책관은 축사를 통해 "반도체 장비 전공트랙 출범은 국내 반도체 산업의 부족한 인력난과 대학생 취업난을 동시에 해결할 수 있는 모델로 대학의 참여를 확대하고, 디스플레이 등 타 분야로도 확대할 수 있도록 노력하겠다."라고 강조했다.

【붙 임】 1. 반도체장비 전공트랙 출범식 개요
2. 반도체장비 전공트랙 설명자료

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 이정남 사무관(☎ 044-203-4273)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1 **반도체장비 전공트랙과정 출범식 개요**

1. 추진 배경

□ 반도체산업의 대규모 시설 투자에 따른 공정·장비 기술이 부각되면서, **반도체장비 기업의 우수 인력 양성이 필요**

○ 반도체장비 전공트랙과정의 본격 추진에 앞서, **산·학·관 긴밀한 협력을 다짐**하는 장 마련

2. 행사개요

□ **일시/장소** : '17. 8. 24(목) 10:00~12:00 / 한국반도체산업협회 9층(판교)

□ **참 석 자** : **(산업부)** 박기영 소재부품산업 정책관, **(인하대)** 최순자 총장, **(대림대)** 황운광 총장, **(명지대)** 이종명 부총장, **(한국산업기술대)** 이재학 대학원장, **(KIAT)** 정재훈 원장, **(반도체 장비)** 박경수 피에스케이(주) 대표, 전공트랙 참여학생 등 90여명

□ **주요내용** : **반도체 전공 트랙 출범 선언문 조인식**

○ 산업통상자원부, 한국반도체산업협회, 반도체장비 기업, 참여대학이 반도체 장비 분야 인력 양성을 위해 상호협력 약정

< 세부 일정(안) >

시간		내용	비고
10:00~10:05	'5	개회 및 참석자 소개	진행자
10:05~10:08	'3	환영사(반도체 장비 대표)	박경수 대표(피에스케이㈜)
10:08~10:11	'3	격려사(산업부)	박기영 소재부품산업정책관
10:11~10:14	'3	격려사(KIAT)	정재훈 원장
10:14~10:27	'13	출범 선언문 조인식	
10:27~10:35	'8	장비 전공 트랙 과정 추진 계획 발표	한국반도체산업협회
10:35~10:55	'20	4개 대학별 세부 추진 계획 발표 (인하대/명지대/산기대/대림대)	담당교수
10:55~11:00	'5	폐회 및 Break	
11:00~11:50	'50	- 반도체 장비산업의 현황과 전망 -	오찬권 대표 (하이엔드테크놀로지)

붙임 2 **반도체장비 전공트랙 설명자료**

1 **(교육과정)** 반도체산업의 대규모 시설 투자에 따른 공정·장비 기술이 핵심 경쟁력으로 부각되면서, 반도체장비 분야의 우수 인력 양성이 필요

○ 반도체장비 전문인력 양성을 위해 반도체 장비 기업 대상의 심층 인터뷰 및 설문 조사를 통해 필요 교육 과정 발굴

- 열·유동으로 인한 균일도 및 스트레스로 인한 신뢰성 확보 필요
  → 기구설계해석 인력 요구

- 고용량의 커패시터를 위한 고성능의 플라즈마 장비 기술 요구
  → 플라즈마 공정개발 인력 요구

- 반도체장비 시스템의 지능화를 위한 장비운영·제어기술·프로그램밍
  → 소프트웨어개발 인력 요구

- 미세화 공정 등 반도체 장비의 첨단화로 인한 장비 유지·보수 중요
  → 장비 유지·보수 인력 요구

○ 전자・기계・소재 등 공과대학 전공에 맞춰 기본 교육프로그램 설계

구분		교과 과정
1학년	공통	- 사회인으로서 기본 소양(교양과목으로 권장), 직무능력 - 반도체 산업, 제조공정 및 장비운영 이해
2학년	공통	- 기초 역학(열, 유체, 재료, 동력), 전기전자 기초, 장비 요소기술(모터, 센서 등) - 소재(Ceramic, PVD, SUS 등), 화학물질/안전관리규정 기초
	전공기초	- 기본 프로그램 : CAD, 회로설계, C언어 등
3학년	공통	- NCS 기반 반도체 장비 개발 : 장비기업에서 하는 일의 전체 흐름 이해 - 반도체 소자/단위 공정, 반도체 장비 핵심모듈(진공, 플라즈마 등) 응용 이해
	전공심화	- 기구설계, 회로설계, 기구제어 등 직무능력 향상을 위한 전문지식 습득 - 각종 시뮬레이션 Tool을 이용한 핵심기술 실습
4학년	1학기	- 전공별 반도체 장비 및 요소기술 실습 : 대학 자체 또는 기업 지원 및 연계
	2학기	기 취업 대상 기업에서 현장 실습 또는 인턴 과정

2 **(전공트랙)** 반도체 장비 기업 요구 교과 과정을 기반으로 4개 대학(인하대, 대림대, 명지대, 한국산업기술대) 전공트랙과정 운영

○ 세분화된 전공에 맞춰 타켓직무를 설정, 교육프로그램 운영

구 분	참여학과	타겟 직무
인하대 (31명)	신소재공학과	반도체 공정 및 장비 소재 개발
	기계공학과	유동 및 기구설계
	전자공학과	공정개발 및 소자연구
	정보통신공학과	소프트웨어 및 시뮬레이션
	화학공학과	플라즈마 교육
대림대 (20명)	메카트로닉스학과	장비 제조 및 필드엔지니어
명지대 (45명)	전자공학과	전장설계 및 필드엔지니어
	기계공학과	기구설계
	신소재공학과	공정개발 및 필드엔지니어
	정보통신공학과	소프트웨어
	산업공학과	품질관리
한국산업기술대 (20명)	메카트로닉스공학과	전장설계 및 전장제어
	나노광공학과	공정개발 및 필드엔지니어

3 **(지원프로그램)** 반도체 장비기업은 대학에 실습장비 기증, 산·학 공동 프로젝트 등을 통해 현장중심의 인력양성 지원

○ 한국반도체산업협회는 대학을 통해 배출되는 우수 인력이 원하는 기업으로 취업할 수 있도록 관련 정보 제공 등 채용 연계 프로그램 운영

